



株式会社バイ・テクノロジー
2024年3月期(第27期)

決算説明会資料

I 本日の内容

- I. 2024年3月期決算
- II. 2025年3月期業績と配当の予想
- III. 中期経営計画

I. 2024年3月期決算

1. 振り返り
2. 連結業績サマリー
3. セグメント別の売上・利益
4. 四半期売上・利益
5. 地域別売上
6. 販売費及び一般管理費
7. 貸借対照表
8. キャッシュフロー計算書
9. 受注・受注残の状況

1. 振り返り

- 期初時点で下期への売上・利益の偏重が見込まれる中、計画達成に向け施策を推進
 - ✓ 下期、特にQ4偏重の影響を軽減するために、売上時期の前倒等の調整を顧客他と実施
 - ✓ 一部顧客向けの延伸影響を避けられず、Q4(3か月)の売上は計画未達ながら、営業利益は計画を概ね達成
 - ✓ 経常利益と当期利益は、為替差益の発生により当社計画に対し開示基準を上回り、上方修正(5/13開示済)
- 半導体・フォトマスク装置事業は、新製品投入効果もあり、受注・売上ともに堅調に推移
 - ✓ 主力事業として成長
 - ✓ 当社グループが注力するアドバンスドパッケージ市場向け製品販売の今後の増加に期待
- 自己株式の取得を2023年11月に実施
 - ✓ 注力事業の進捗などを踏まえ、当時の株価水準は資本効率の向上および株主還元を行うにあたり最適と判断
- 昨年11月に中期経営計画の公表をご案内
 - ✓ 本日の決算説明会にて詳細について当社代表の杉本よりご報告いたします。

2. 連結業績サマリー

- 概ね計画通りの着地
 - ✓ 計画比達成率:売上高93.3%/営業利益84.6%/経常利益130.8%/当期利益141.5%
- 半導体・フォトマスク装置事業が主力事業に成長
- 当期純利益は、FY23/3比増益(FY23/3:税金費用1,434百万円)

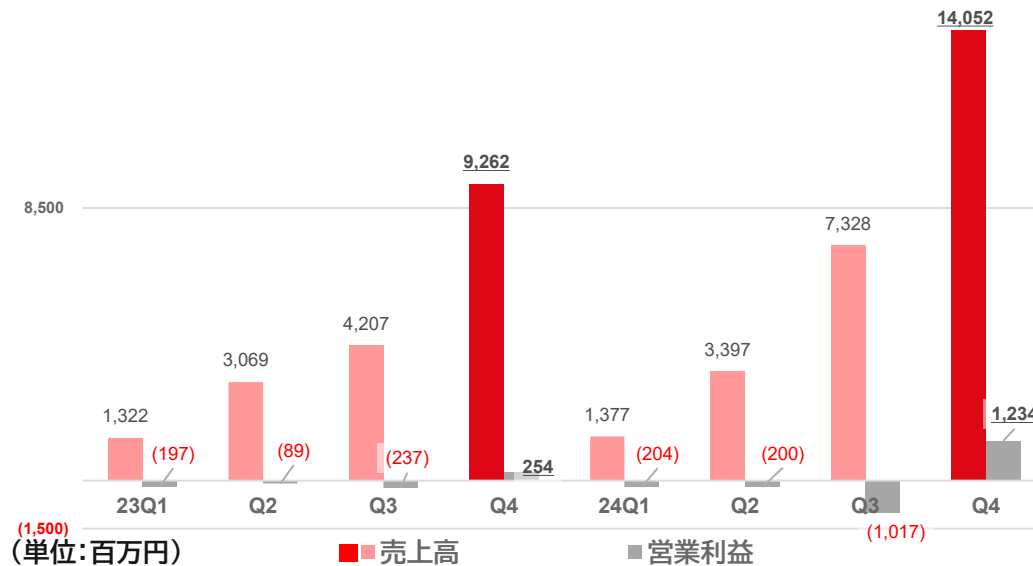
(百万円)	FY23/3	FY24/3			
	実績	業績予想 (2024/2/8時点)	実績	予想比	前年同期比
売上高	43,146	40,000	37,335	▲6.7%	▲13.5%
営業利益	986	1,000	846	▲15.4%	▲14.2%
(利益率%)	2.3%	2.5%	2.3%	▲0.2%	0.0%
経常利益	1,700	850	1,112	+30.8%	▲34.6%
(利益率%)	3.9%	2.1%	3.0%	+0.9%	▲0.9%
親会社株主に帰属する当期純利益	260	550	778	+41.5%	199.1%
(利益率%)	0.6%	1.4%	2.1%	+0.7%	+1.5%

3. 各セグメントの連結売上高・営業利益の状況

- 半導体・フォトマスク装置事業……ウェハ、DI、マスクの各事業が伸長
- FPD装置事業………売上減およびOLED関連子会社事業の不振により減収減益

半導体・フォトマスク装置事業

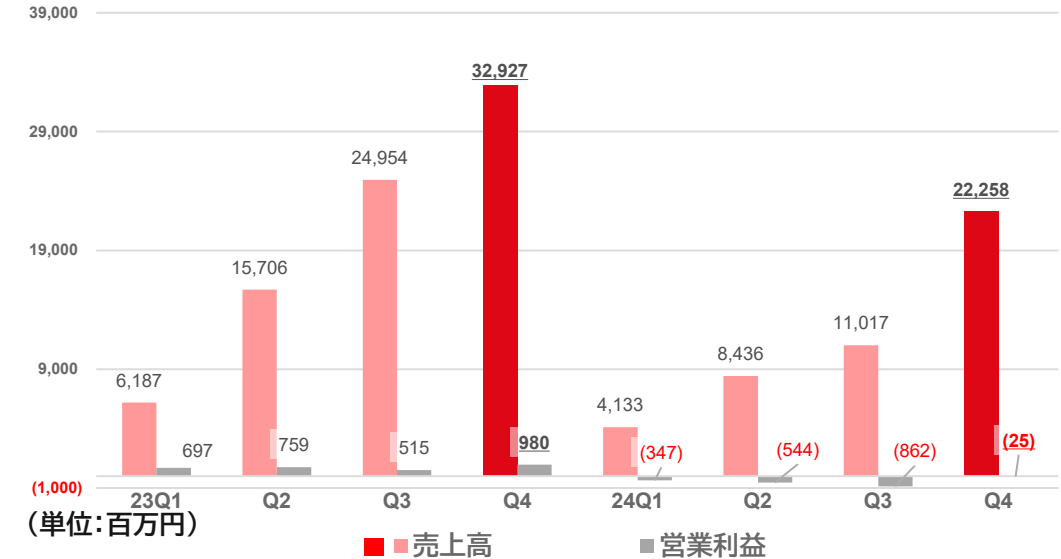
	FY23/3	FY24/3	前年比
売上高	9,262	14,052	+51.7%
営業利益 (セグメント利益率)	254 (2.7%)	1,234 (8.8%)	+385.8%



半導体・フォトマスク装置事業: 半導体製造工程における製造装置、検査装置及びフォトマスク用装置等の開発・設計・製造・販売・関連サービス、及びPCB用装置で構成
 FPD装置事業: FPD製造工程における製造装置、検査装置等の開発、設計、製造、販売、関連サービス及びOLED用蒸着マスクをはじめとする部材等で構成

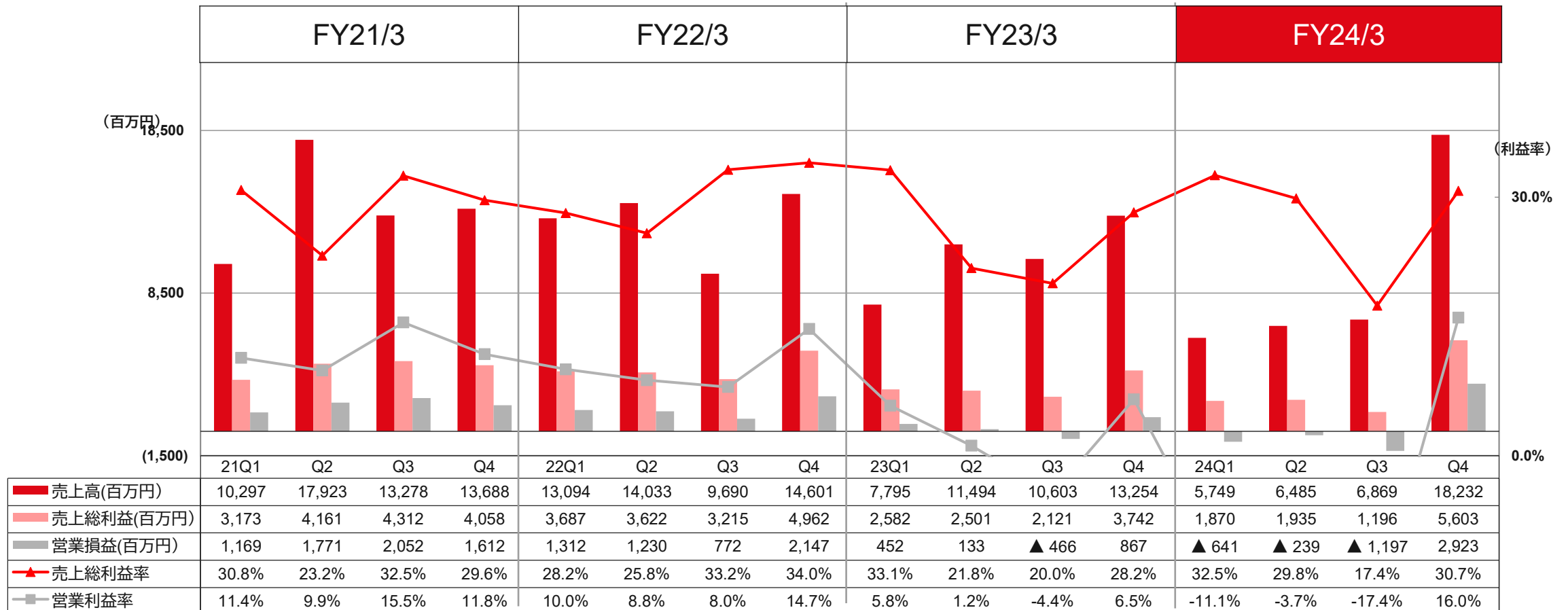
FPD装置事業

	FY23/3	FY24/3	前年比
売上高	32,927	22,258	▲32.4%
営業利益(▲損失) (セグメント利益率)	980 (3.0%)	▲25 (-%)	(-%)



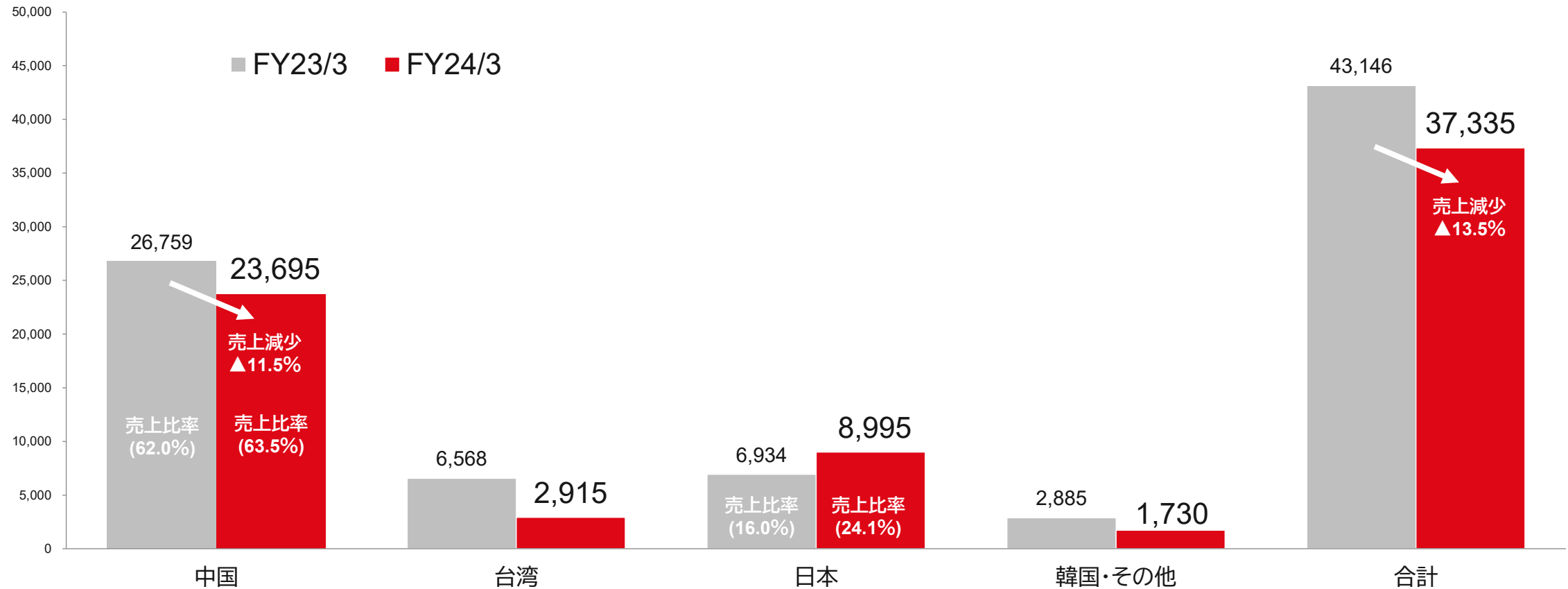
4. 四半期売上・利益の推移

- Q1～Q3(9か月)の営業損失(▲21億円)を、Q4(3か月)の営業利益(29億円)でカバーし、通期で黒字化
- Q4(3か月)の売上高・売上総利益・営業利益は、過去16四半期で最高額を記録



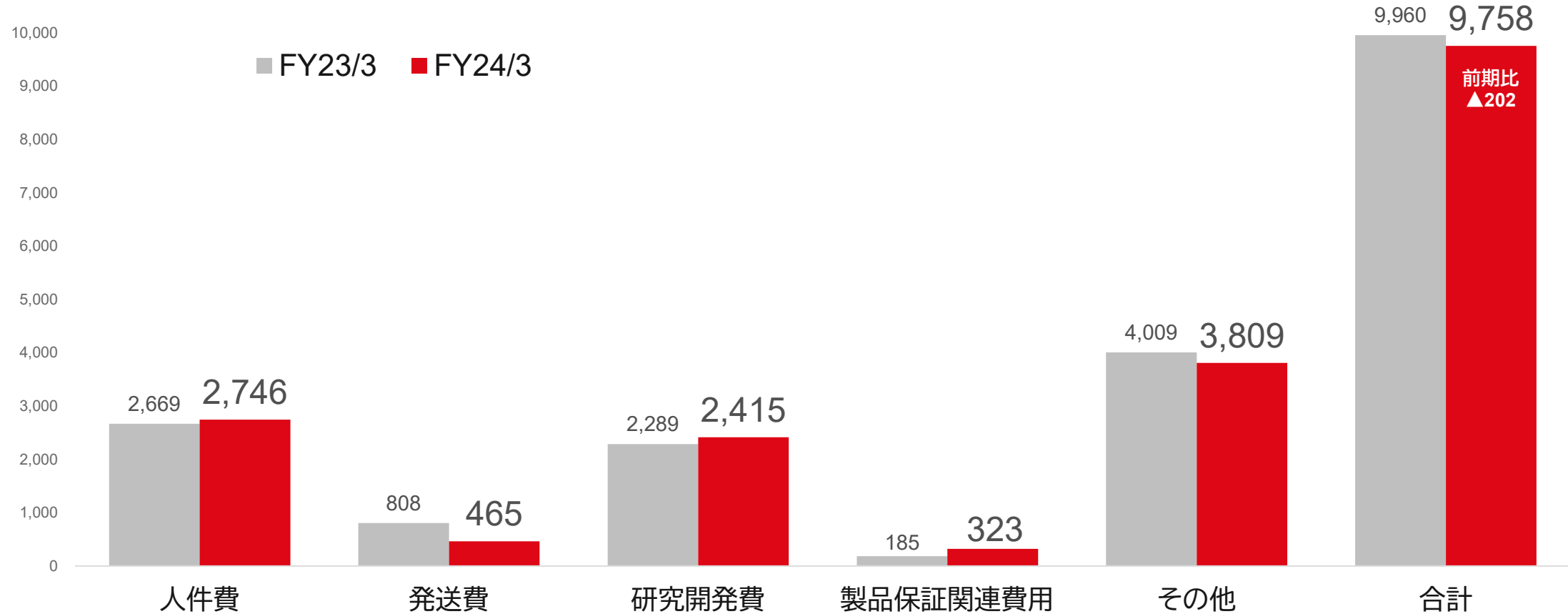
5. 地域別売上高 (単位:百万円)

- 中国: FPD関連の売上が減少
- 日本: 半導体関連の売上が増加



6. 販売費及び一般管理費 (単位:百万円)

FPD装置の売上減による発送費の減少、新製品開発に伴う研究開発費の増加等により202百万円の減少

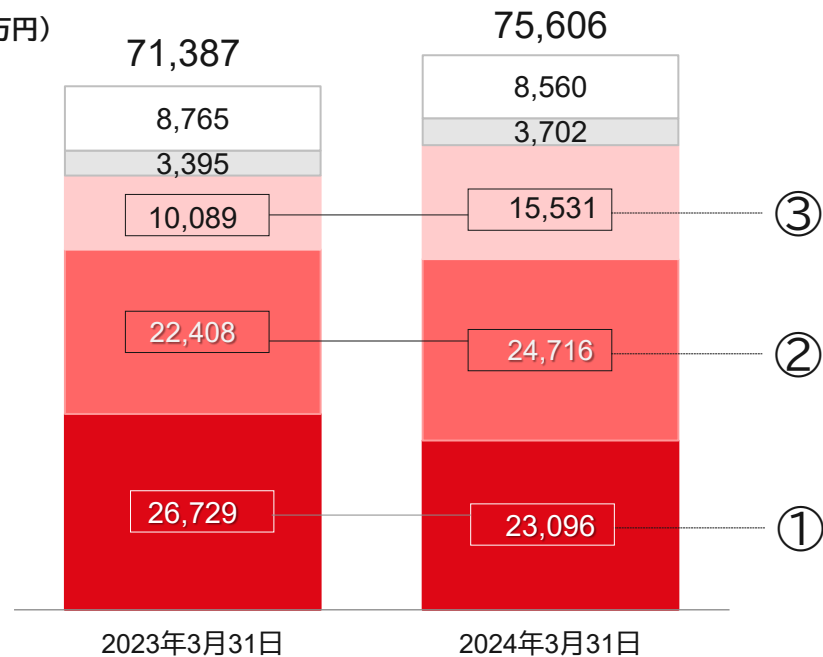


7. 貸借対照表

- ① 現預金……………運転資本の増加、前受け金の減少等により3,633百万円減少
 ② 受取手形及び売掛金……………FY24/3 Q4の売上増により2,308百万円増加
 ③ 棚卸資産……………FY25/3の売上げの為の仕掛品等の増加により5,442百万円増加
 ④ その他流動負債……………仕掛品の増加等の結果、1,126百万円増加

総資産

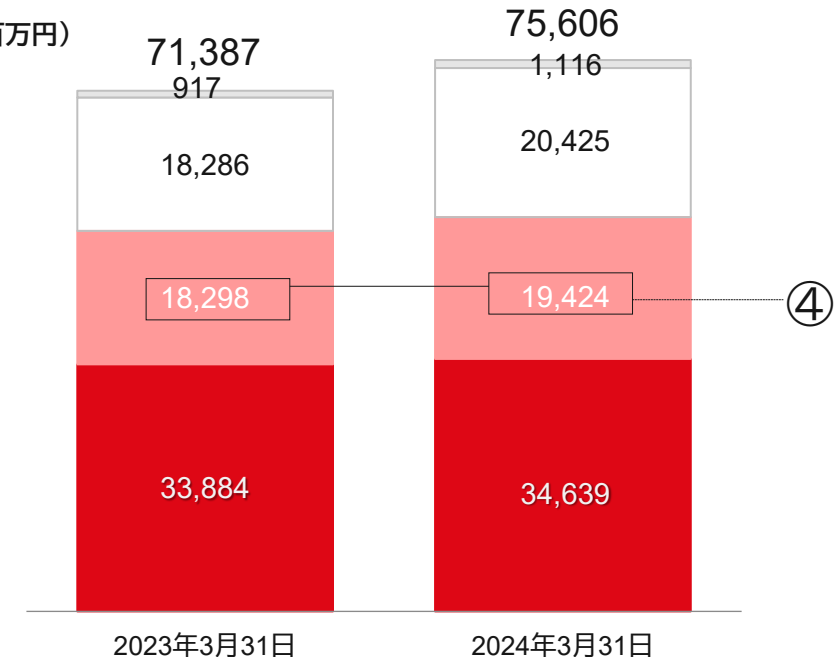
(単位:百万円)



■ 現金及び預金 ■ 受取手形及び売掛金 ■ 棚卸資産
 ■ その他流動負債 ■ 固定資産

負債・純資産

(単位:百万円)



■ 純資産 ■ その他流動負債 ■ 借入金(短期・長期) ■ その他固定負債

8. キャッシュフロー計算書

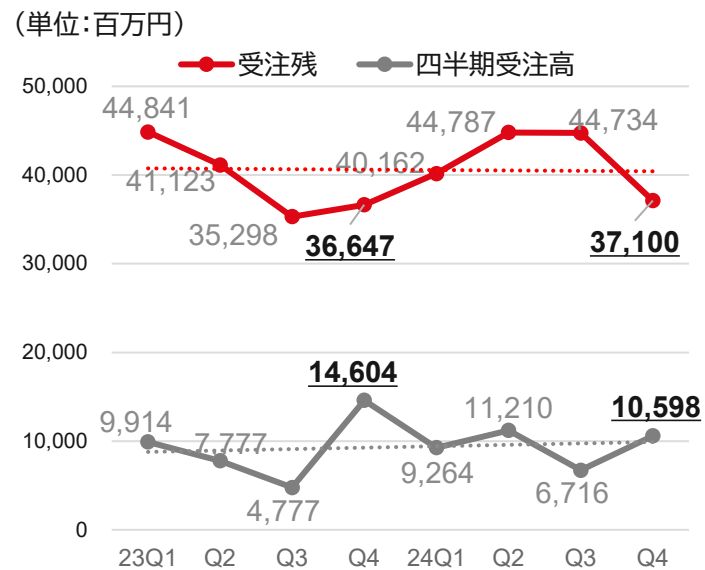
FY25/3の売上増に向けて棚卸資産及び仕入債務が増加、今後圧縮予定

金額単位:百万円		FY23/3	FY24/3
営業活動による キャッシュフロー	税金調整前純利益	1,571	1,181
	売上債権(増加▲)	▲2,255	▲2,278
	棚卸資産(増加▲)	1,814	▲5,397
	仕入債務(減少▲)	▲4,443	4,816
	前受金(減少▲)	▲468	▲3,746
	その他	497	660
	Total	▲3,284	▲4,764
投資活動によるキャッシュフロー Total		▲1,195	▲440
財務活動による キャッシュフロー	借入による収入	8,218	10,618
	返済による支出	▲4,297	▲8,490
	その他	▲1,141	▲602
	Total	2,780	1,526
現金及び現金同等物に關わる換算差額		217	276
現金及び現金同等物の増減額(減少▲)		▲1,482	▲3,402
現金及び現金同等物の機首残高		27,778	26,295
現金及び現金同等物の四半期末残高		26,295	22,893

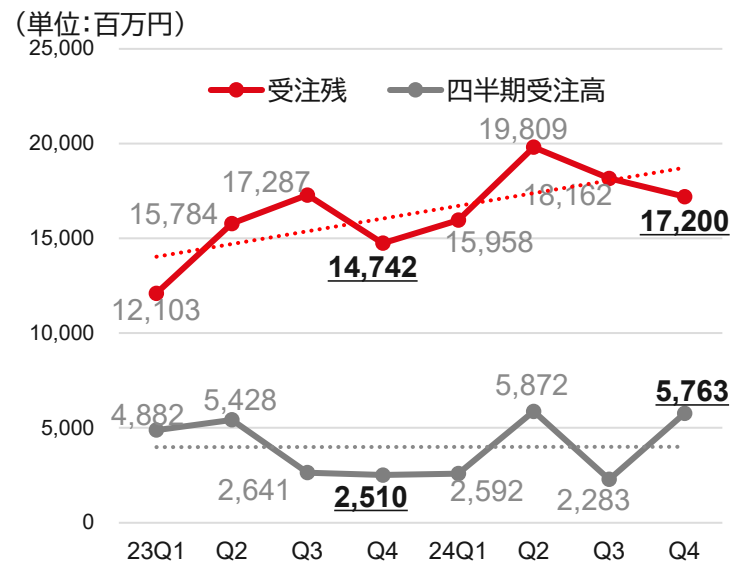
9. 受注・受注残の状況

- 半導体・フォトマスク装置事業……ウェハやフォトマスク関連装置の受注が回復
- FPD装置事業………一部で成約が遅れたが、メンテナンスと既存工場の増強で受注が継続

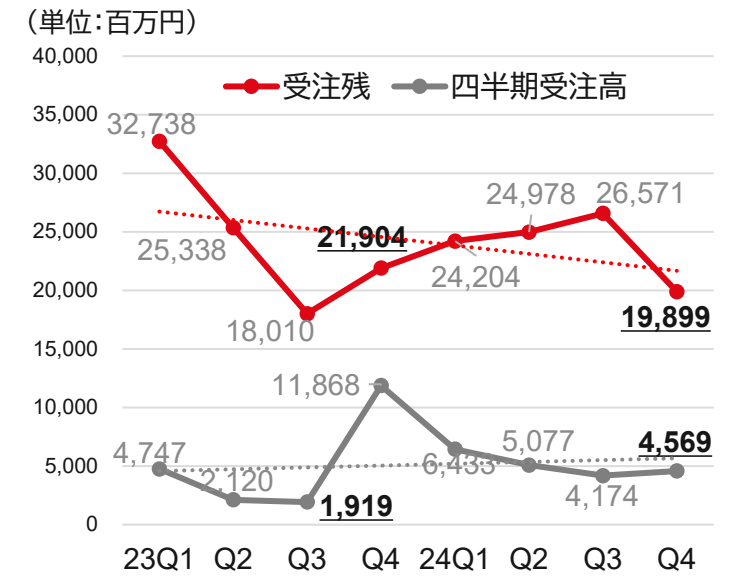
グループ全体			
	FY23/3	FY24/3	前年比
受注残	36,647	37,100	+3.1%
受注高(累計)	37,072	37,788	+1.9%



半導体・フォトマスク装置事業			
	FY23/3	FY24/3	前年比
受注残	14,742	17,200	+16.7%
受注高(累計)	15,461	16,510	+6.8%



FPD装置事業			
	FY23/3	FY24/3	前年比
受注残	21,904	19,899	▲9.2%
受注高(累計)	20,654	20,253	▲1.9%



Ⅱ. 2025年3月期 業績と配当の予想

通期業績及び配当予想

- 半導体・フォトマスク装置事業の成長を見込み、前期比で増収増益を予想
- 四半期決算は、現時点では、売上・利益ともに第4四半期に偏重見込み(改善検討中)
- 配当については、通期で80円(前期比+20円の増配)を予想

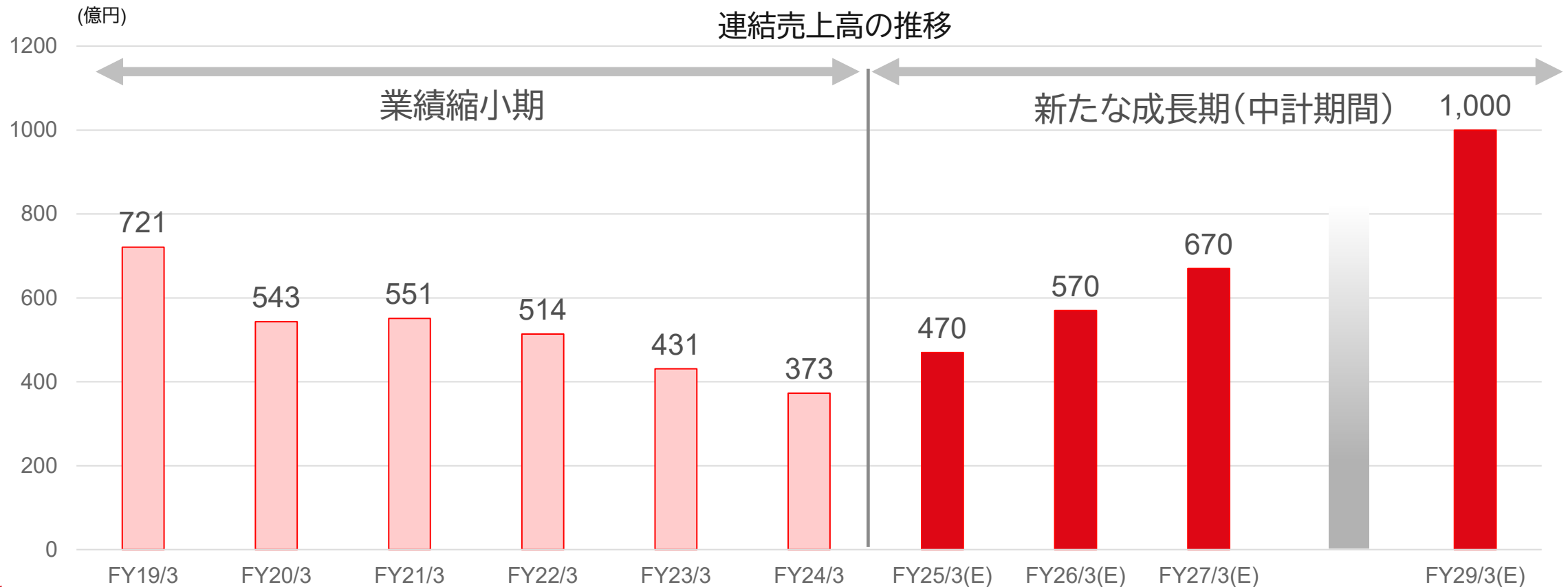
(百万円)		FY24/3実績	FY25/3 通期業績及び配当予想	
		金額	金額	前期比
売上高		37,335	47,000	+ 25.9%
営業利益		846	1,600	+ 89.1%
(利益率)		2.3%	2.5%	
経常利益		1,112	1,400	+ 25.9%
(利益率)		3.0%	2.1%	
親会社株主に帰属する当期純利益		778	1,000	+ 28.5%
(利益率)		2.1%	1.4%	
EPS(円)		80.65	103.90	+ 23.25
配当(円)	中間	30(実績)	40	+ 10
	期末	30(予定)	40	+ 10

Ⅲ. 中期経営計画

1. はじめに
2. 数値目標
3. 具体的な施策

1. はじめに(1/3)

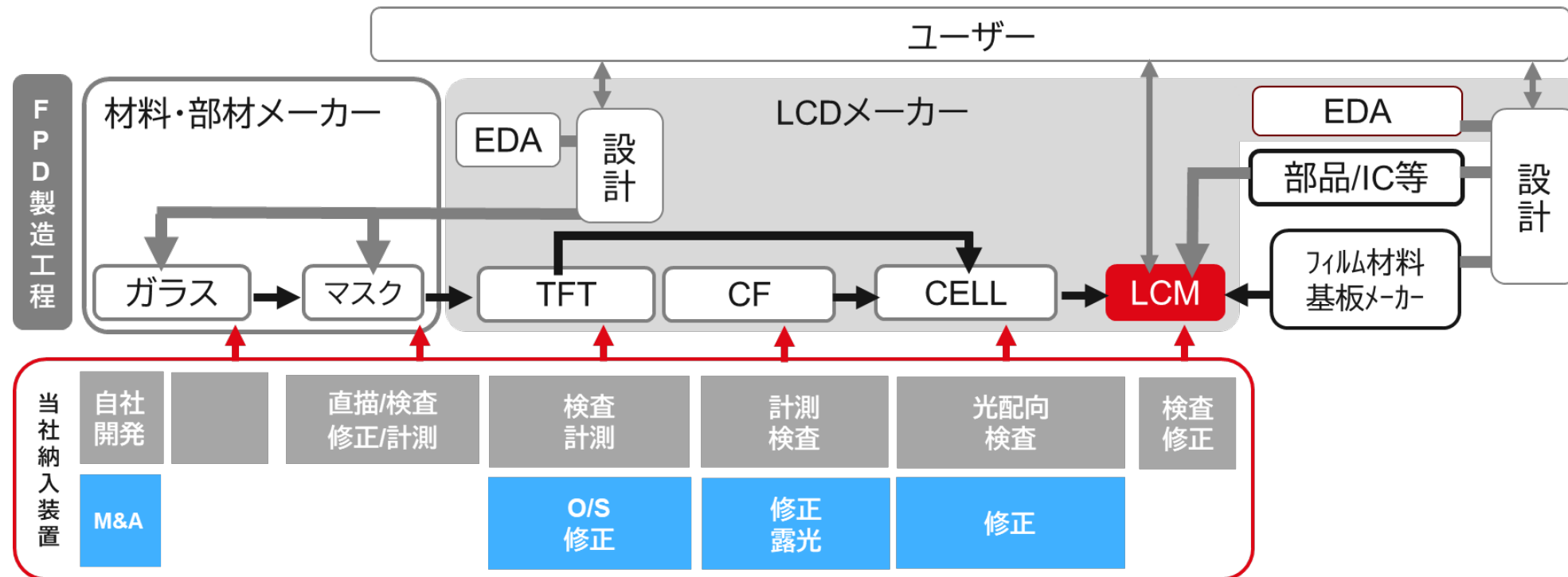
- ・ 当社グループは、社会的課題に対するイノベーションに取組み、持続的成長を目指しています。
- ・ 今般、業績低迷時期から脱却し、新たな成長期を迎え、今後5年間の成長プランを中期計画として発表いたします。



1. はじめに(2/3) FPD装置事業でのこれまでの取組

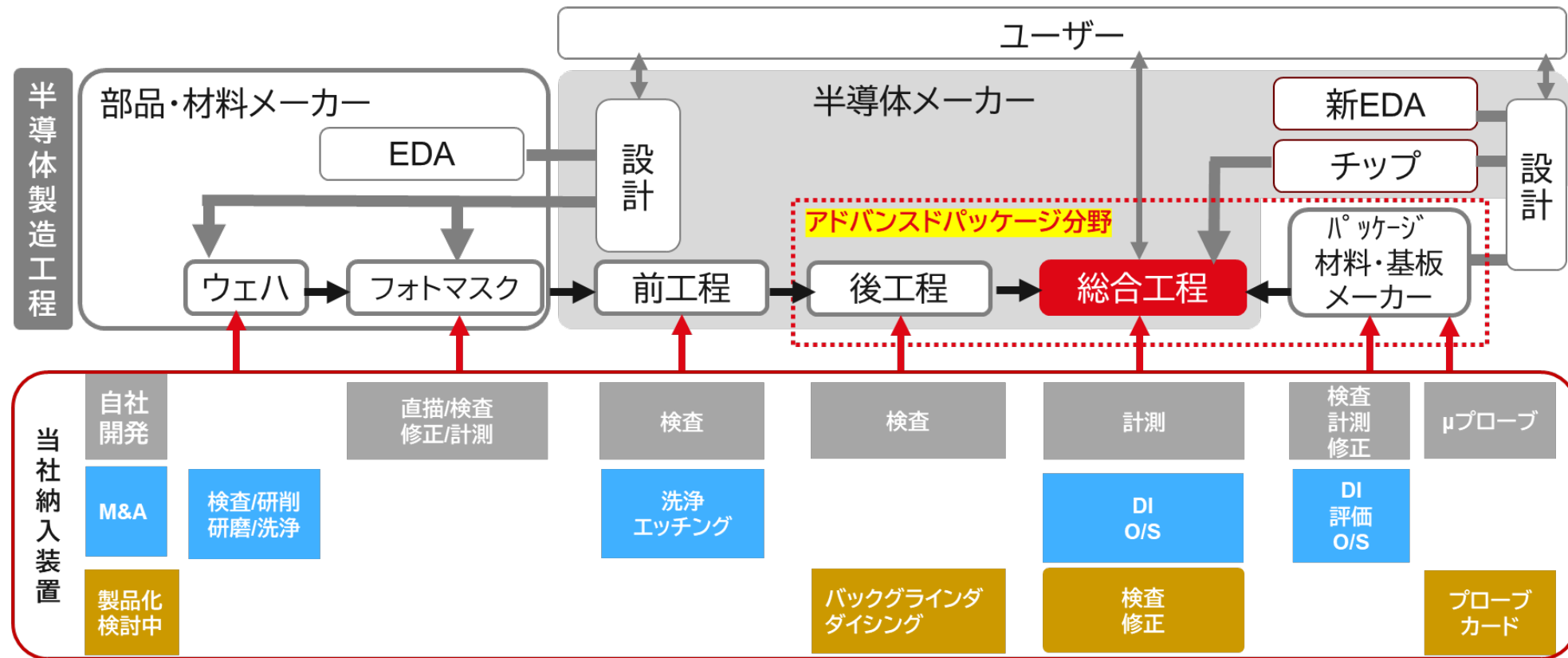
製造工程の上流から下流までを網羅したパッケージ戦略*で売上規模の拡大に成功し、2019年3月期には、売上高721億円を実現

*パッケージ戦略: 自社開発新製品の投入、及びM&A等による外部製品の取込みによる製品群拡大



1. はじめに(3/3) 半導体・フォトマスク装置事業でのこれから

- FPDと同じくパッケージ戦略にて取組中
- 事業の安定化を目的に、部材事業の初期より立上げ(μ プローブ/プローブカード他)
- アドバンスドパッケージ分野への注力(後工程/総合工程/基板・材料製造)



2. 数値目標

- 売上高(高付加価値製品を主とした)を一定規模(600億円程度)以上にすることで、ROE・PBR(株価)は大幅に改善していくものと考えています。

2018年3月期:売上高660億円/営業利益125億円/ROE40.9%/PBR7.3倍/株価15,250円(分割後株価・2018年3月末時点)

2019年3月期:売上高721億円/営業利益166億円/ROE40.6%/PBR2.5倍/株価7,015円(分割後株価・2019年3月末時点)

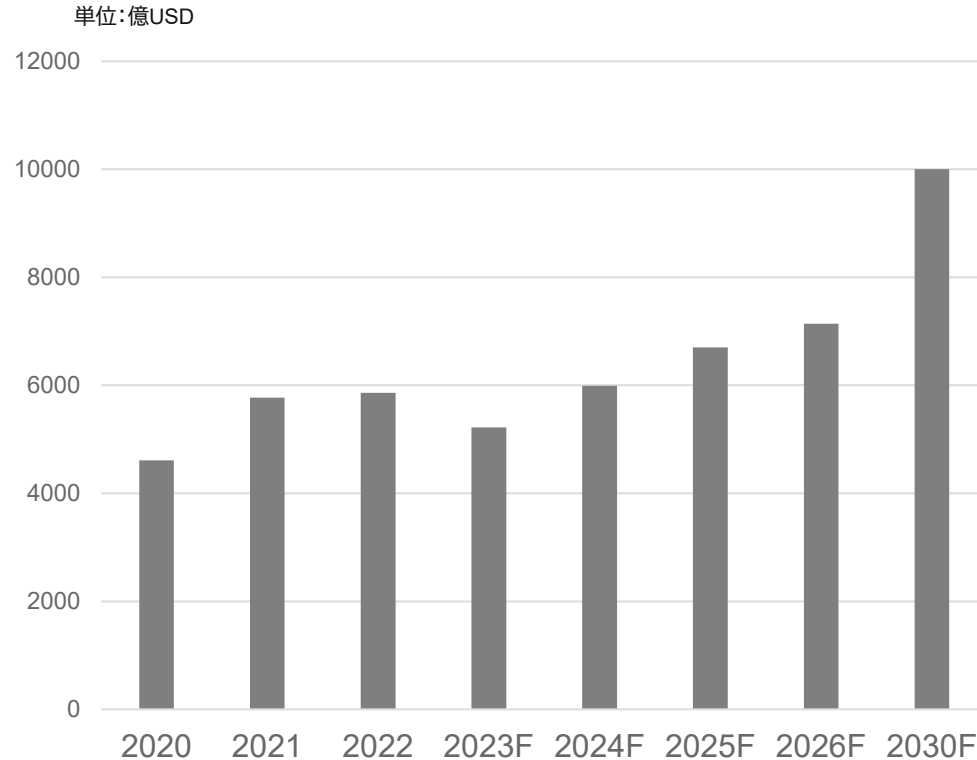
- 2025年3月期は、半導体・フォトマスク装置事業の成長による売上高470億円/営業利益16億円を見込む
- 2026年3月期以降は、売上高が一定規模に達することで、利益の大幅増加を見込む
- 2029年3月期は、売上高1,000億円/営業利益200億円を目指す

指標等	2024年3月期(実績)	数値目標			
		2025年3月期	2026年3月期	2027年3月期	2029年3月期
売上高(億円)	373	470	570	670	1,000
半導体・フォトマスク事業	140	225	316	358	680
FPD事業	223	230	230	280	250
新規事業	10	15	24	32	70
営業利益(億円)	8.5	16	45	74	200
営業利益率	2.3	3.4	7.9	11.0	20.0
*ROE (%)	2.3	2.9	8.2	12.5	23.7

3. 具体的な施策 半導体・フォトマスク装置事業(事業環境)

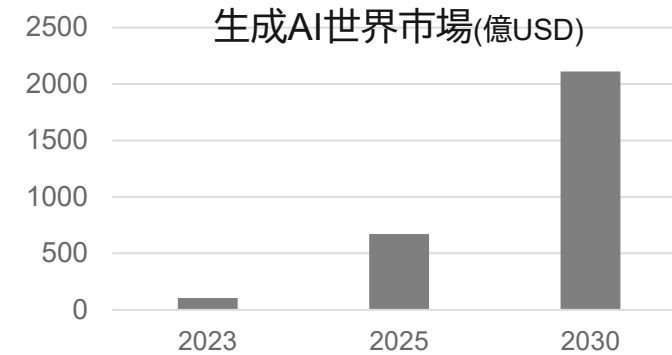
- 半導体市場は、裾野が広く、当社グループが持つ強みを活かす機会が豊富な分野
- 今後の持続成長が見込まれる半導体製造の分野に新しい製品・サービスを投入

半導体市場は2030年に1兆USDに



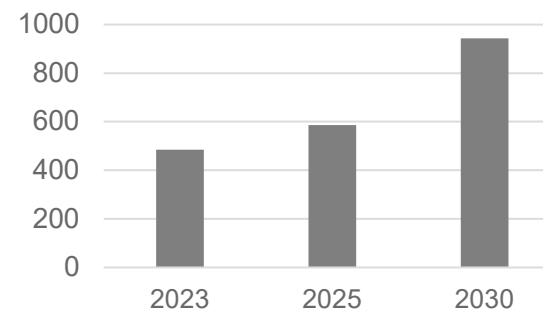
OMDIA資料より当社にて作成

生成AIの普及が、アドバンスドパッケージ市場拡大を牽引

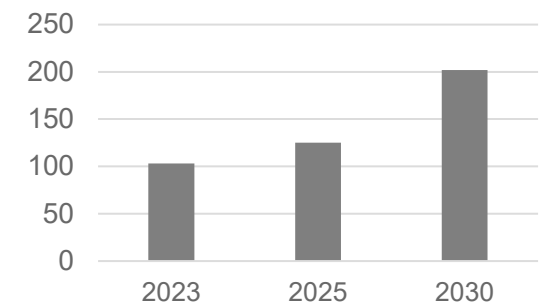


電子情報技術産業協会(JEITA)より当社にて作成

アドバンスドパッケージ市場(億USD)



HPC用パッケージ(億USD)



Yole資料より当社にて作成

3. 具体的な施策 アドバンスドパッケージ分野への注力

AI用途等、最先端の半導体用パッケージング技術の微細化に対応する製品をラインナップ

- ✓ IMAGINA: 高性能CPUパッケージ基板の量産に業界で初めて対応、L/S=4/4 μm を高タクトで実現
- ✓ LAMDI: 樹脂インターポーザ、ガラスキャリア、ガラスコア基板等の量産を視野に開発、最小1 μm に対応する高性能機
- ✓ O/Sテスタ: グループの電鍍技術による μ プローブを用い、20 μm の狭ピッチ端子に対応する電気検査に業界初対応

HPC用ICパッケージ基板露光



DI露光装置
IMAGINA(イマジナ)
シリーズ

インターポーザー基板露光

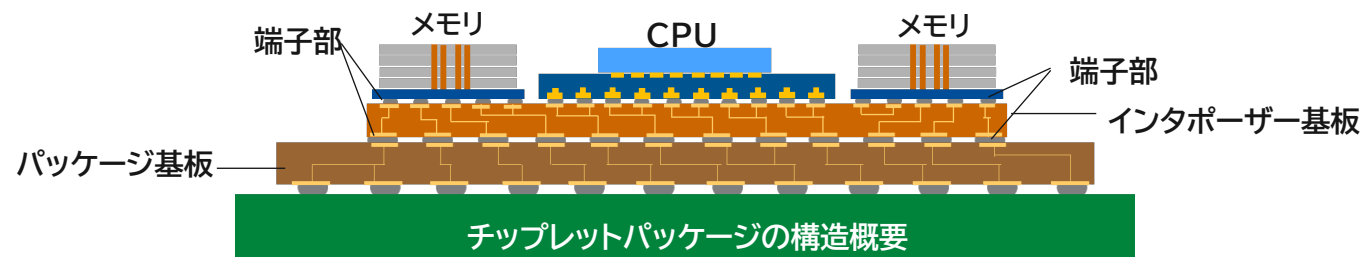


DI露光装置
LAMBDI(ラムディ)
シリーズ

狭ピッチ端子の電気検査



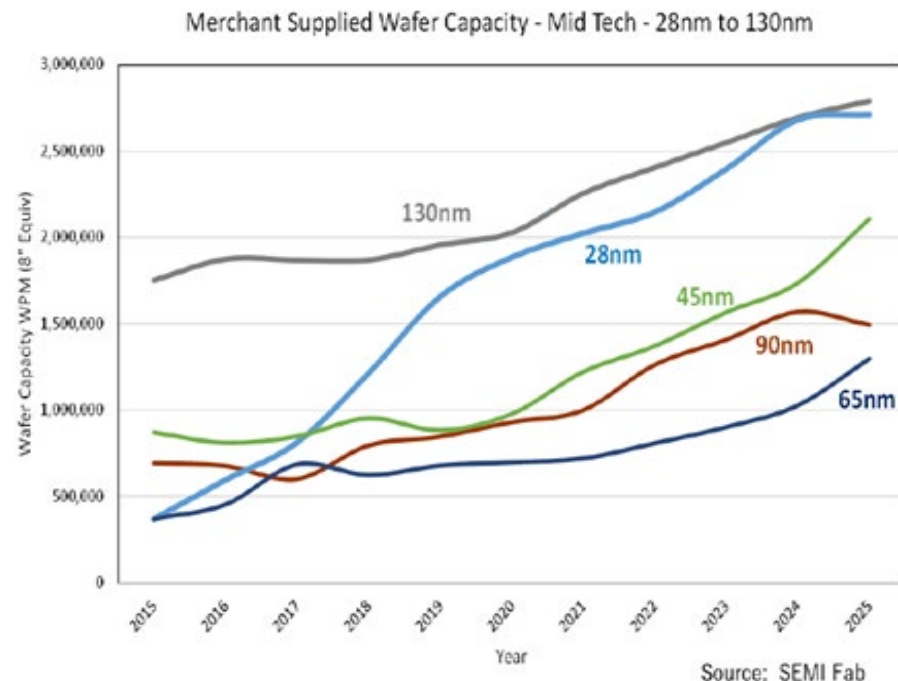
O/Sテスター
 μ プローブを採用



3. 具体的な施策 フォトマスク分野での製品展開

- ・ パワーIC等、レガシー半導体用フォトマスク製造装置の需要増
- ・ 1990～00年代初頭の装置の置換え需要への対応: グローバルで200～300台程度と推計
 - ✓ 後継装置なく、保守・メンテナンスサービスが停止され、生産性の面でも課題
 - ✓ 既存工場特有の制約等に対応し、性能面でも優れた製品ラインナップ

レガシー半導体の製造能力は増加傾向



欠陥検査装置「Dione」

特長

- ・ 透過・反射検査を同時処理
- ・ 従来比で検査時間を1/4短縮
- ・ 省スペース設計



フォトマスクレジストレーション装置「PMARS」

特長

- ・ 電子回路寸法・位置の測定
- ・ 重ね合わせ測定再現性: 3nm (1nm=10億分の1メートル)



3. 具体的な施策 シリコンウェハ/研究開発用装置の展開

- ・シリコンウェハの需要は、長期的に拡大する見込み
- ・シリコンウェハ結晶欠陥検査: 高性能半導体向けの高品質シリコンウェハ検査に対応
 - ✓ 他に、3D積層に関連してのウェハ平坦度管理等の需要も増加
- ・ラボ用装置について、EUV用材料開発やデバイス試作用途におけるグローバルな需要の拡大

シリコンウェハ製造

| 結晶欠陥検査装置

- ・シリコン塊内部に発生する 結晶欠陥の検査
- ・12インチ対応
- ・業界最高速タクト: 133枚/時



ラボ用装置

| マスクレス露光装置

- ・各種半導体デバイスの開発(少量多品種製造)
- ・バイオ関係(マイクロ流路等)
- ・発光素子開発、高周波回路の開発、他



| フォトレジスト評価装置

- ・g線/i線レジスト、ポリイミド材料
- ・EB/EUV/ArF/KrF等用途のフォトレジスト
- ・アルカリ現像液等による各種現像



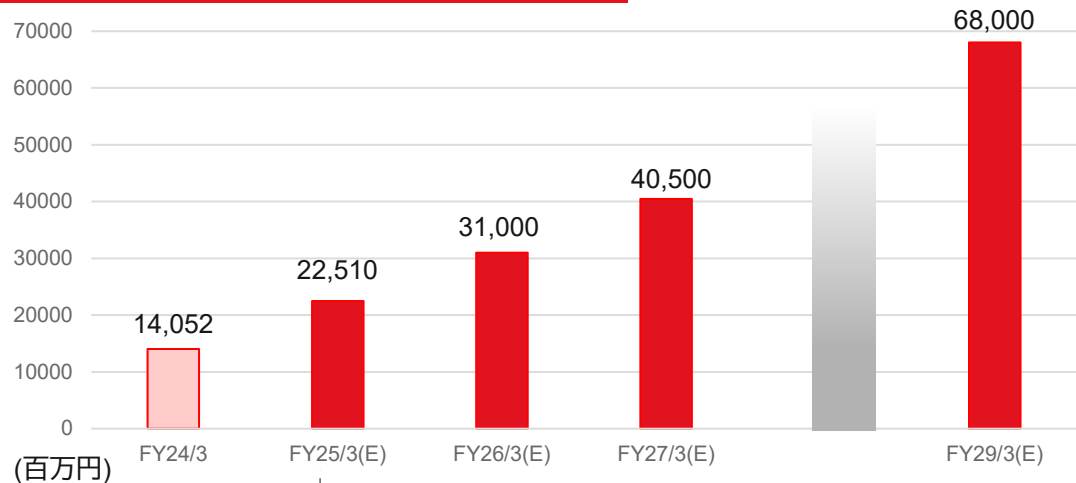
3. 具体的な施策 半導体・フォトマスク装置事業(まとめ)

アドバンスドパッケージ分野での事業展開に加え、他分野での新製品投入、置換え需要の獲得等

主な施策

- ・ アドバンスドパッケージ分野への注力
- ・ 置換え需要への取組(ウェハ、フォトマスク、他)
- ・ SiC/GaN市場への取組
- ・ 部材・サービス・ロイヤリティビジネスの拡大
- ・ ラボ用装置のグローバルな拡販

売上高の目標



事業環境

	短中期	長期
アドバンスドパッケージ	AI用途の需要増/他用途の停滞～回復	DX/GX/AI普及等を背景とした需要増
半導体製造(ウェハ)	ウェハ製造能力の持続拡大(足元停滞)	Si/SiCウェハ高品質化/旧式機の置換え需要
同(ラボ用)	EUV/レガシー半導体/チップレット	SDG's対応/EVU関連材料/再生材料
フォトマスク	EOL装置の置換え需要/パワー半導体市場成長	置換え需要/産業機器半導体需要増

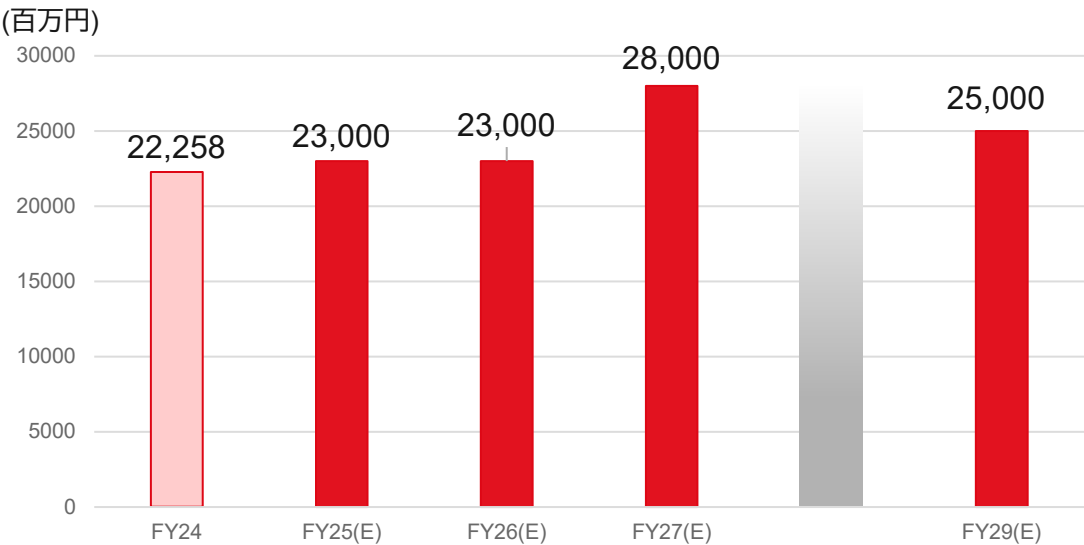
3. 具体的な施策 FPD装置事業

成熟市場での残存者利益の獲得を目指し、外部環境変化に柔軟に対応すると共に、差別化を推進

主な施策

- ・ インド市場、成長分野への参入
- ・ 現地生産化
- ・ 国内外子会社の統廃合
- ・ 部材・ロイヤリティビジネス注力
- ・ 装置検収の早期化
- ・ 他社との協業や、M&Aによる技術・ビジネス獲得

売上高の目標



事業環境

短中期

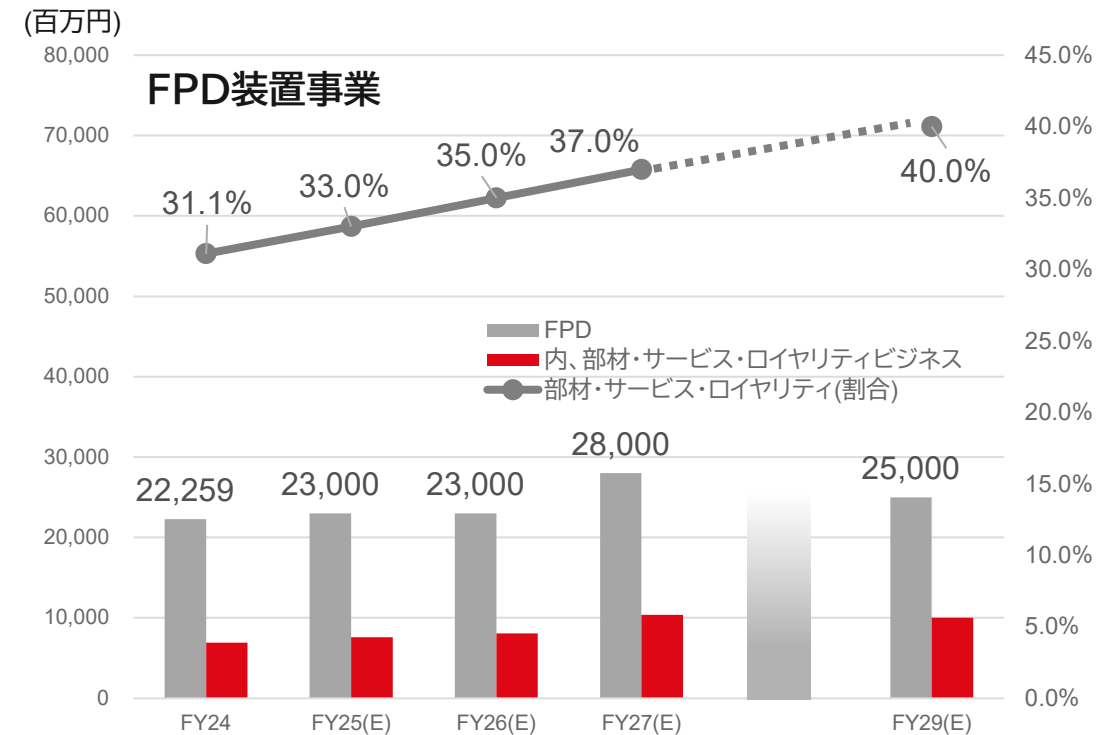
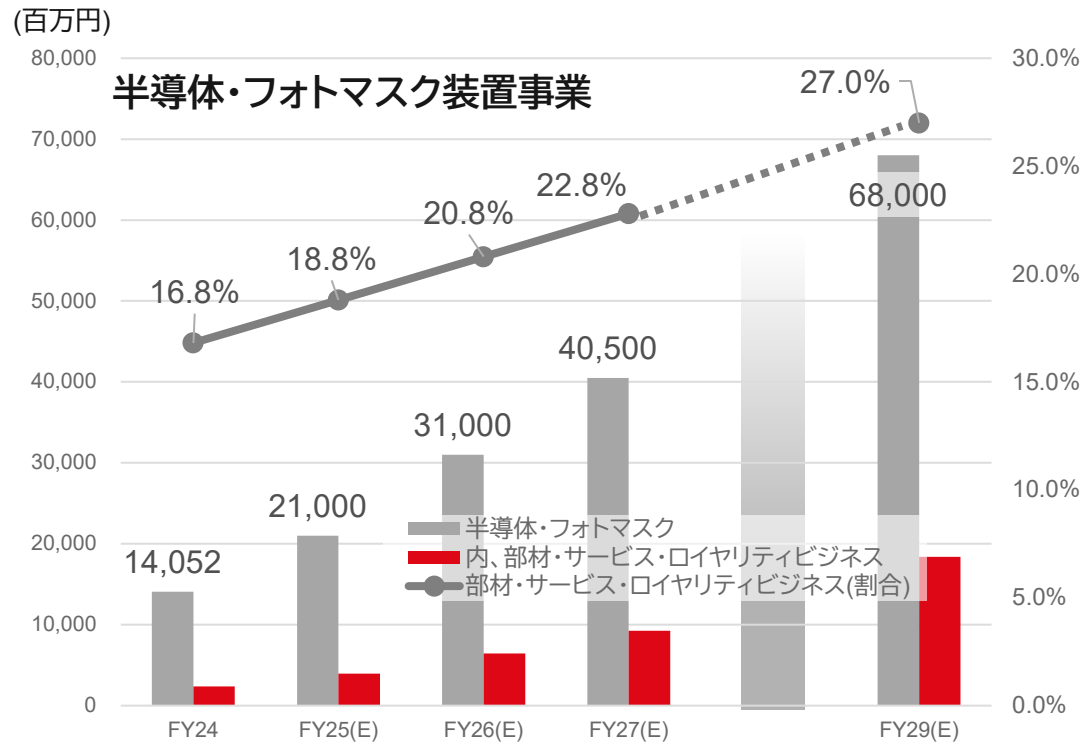
LCD	設備投資の低迷継続/インド投資
OLED	中型用の設備投資、小型市場の成熟

長期

需要回復/投資再開
大型用の設備投資、AR/VR用需要

3. 具体的な施策 部材・サービス・ロイヤリティビジネス

- ランニングビジネス強化による業績の安定化(設備投資に左右されにくい事業構造の構築)
 - ✓ 半導体・フォトマスク装置事業……フォトプローブ/チップレット設計ツール/ロイヤリティ他の推進
 - ✓ FPD装置事業……サルベージサービス/蒸着マスク/ロイヤリティ他の推進



セグメント別の売上高と(左軸)、部材・サービス・ロイヤリティビジネス(右軸)の割合

3. 具体的な施策 新規事業分野での取り組み等

社会的課題に対するイノベーションの実現に向けて

主な施策

農業

- ・ トマト生産拡大(自社/フランチャイズ)
- ・ 販路開拓(生鮮野菜/加工品原料/直販・卸)に基づく事業拡大
- ・ 自動化/省力化に寄与する農業技術の開発

IT

- ・ ソフトウェアの内製強化によるグループ内各種事業のコストダウン及び競争力強化

事業環境

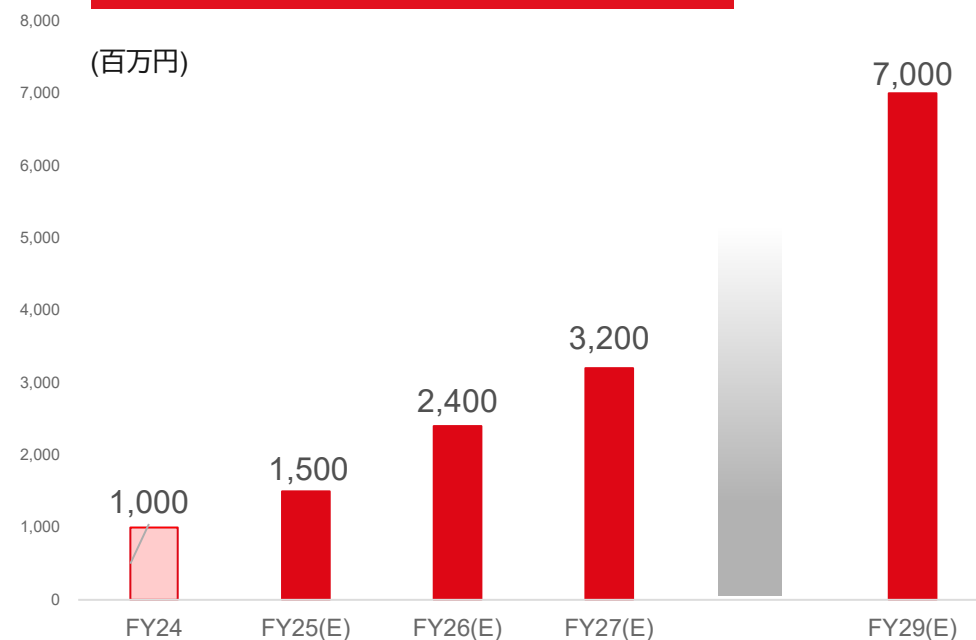
農業

国内農業生産と農業人口の減少、食の安全への関心の高まり、国内農産物輸出拡大

IT

DX/ITの流通・医療・金融等での進展による、ITエンジニア市場の持続的な成長

売上高の目標



3. 具体的な施策 地域展開

現在の地域展開

- ・FPDの顧客向けに顧客基盤構築
- ・営業/サービス拠点
2000年:韓国(3拠点)
2001年:台湾(2拠点)
2007年:中国(15拠点)
- ・現在、国内拠点合わせ24拠点

今後の展開

東アジア地域
(日中韓台)

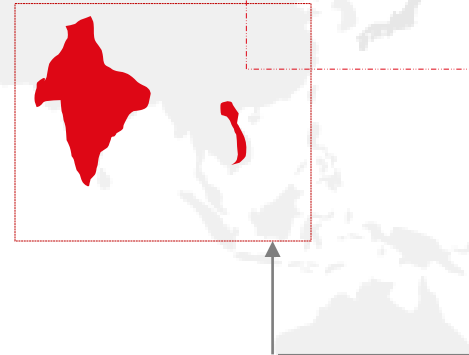
■ グループ会社間での既存拠点の有効活用

・新しい地域への展開

■ インド…LCD/半導体の新工場対応

■ ベトナム・タイ等…製品生産拠点として
米国・欧州…重要市場として認識

・収益拡大を支える拠点を整備



・将来見通し

本資料に記載されている当社の計画、戦略、見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待、見積、予想に基づいています。これらの期待、見積、予想は、経済情勢・市況の変化、競争環境の変化、顧客のある国の政策変化、係争中及び将来の訴訟の結果など多くの潜在的リスク、不確実な要素、過程の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる結果となる可能性があります。従って、これら将来予想に関する記述に全面的に依拠することは差し控えて頂きますようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

・数字の処理

記載された金額は、単位未満を切り捨て処理、比率は単位金額で処理した結果を四捨五入している為、内訳と一致しない場合があります。

お問合せ先

社長室 IRグループ
vtj-mng-pre@vtec.co.jp

